

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）。
成都士兰为本公司之控股子公司

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

公司本次拟为成都士兰5亿元项目贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为成都士兰实际提供的担保余额为2.69亿元

● **本次担保无反担保**

● **公司不存在逾期对外担保**

● **特别风险提示：**截至本公告披露日，公司合计担保余额占最近一期经审计净资产的 52.27%，敬请投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

1、本公司之控股子公司成都士兰半导体制造有限公司拟向国家开发银行四川省分行申请项目贷款人民币 5 亿元或等值美元，用于“汽车半导体封装项目（一期）”建设，贷款期限 10 年。本公司拟为成都士兰该笔贷款本金及利息等费用提供全额全程第三方连带责任保证担保。同时，成都士兰以该项目形成的主要工艺设备提供抵押担保。除本公司外的其他股东不参与成都士兰的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。

2、本次担保不构成关联担保。本次担保无反担保。

3、截至本公告披露日，公司为成都士兰实际提供的担保余额为 2.69 亿元。

4、2023 年 8 月 17 日，公司召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人成都士兰的基本情况

公司名称	成都士兰半导体制造有限公司
统一社会信用代码	91510121564470905W
成立时间	2010年11月18日
注册地址	四川省成都市金堂县淮口街道成都-阿坝工业集中发展区士芯路9号
法定代表人	陈向东
注册资本	316,969.70万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	硅外延制造；芯片和模块封装

2、成都士兰现有股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
杭州士兰微电子股份有限公司	171,333.33	54.05	货币
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	75,757.58	23.90	货币
成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	32,575.76	10.28	货币
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	32,000.00	10.10	货币
成都天府水城鸿明投资有限公司	5,303.03	1.67	货币
合计	316,969.70	100.00	-

截至目前，成都士兰的实收资本为 173,787.88 万元。

3、成都士兰最近一年及一期的主要财务数据（合并报表口径）如下：

（单位：人民币 万元）

项 目	2023年6月末/2023年1-6月 (未经审计)	2022年末/2022年度 (经审计)
资产总额	341,759	269,591
负债总额	137,659	135,584
净资产	204,100	134,007
营业收入	74,687	127,633
净利润	-975	4,258

4、成都士兰为本公司之控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。在获得股东大会审议通过的前提下，公司提请授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司成都士兰“汽车半导体封装项目（一期）”建设的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人成都士兰为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。除本公司外的其他股东不参与成都士兰的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

公司于2023年8月17日召开的第八届董事会第九次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。在股东大会批准本次担保事项的前提下，公司提请授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

六、公司担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为46.566亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.15%。公司对控股子公司提供的担保总额为34.13亿元、控股子公司之间提供的担保总额为1.37亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的48.14%；公司为参股公司厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.14%；公司为参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的担保总额为2.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.87%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023年8月19日